

## WS FLUX EN PASTA

### Características

- Excelente humectación
- Amplia ventana de proceso
- Residuos fáciles de limpiar
- Larga vida al abrirse

### DESCRIPCIÓN

El Flux en Pasta WS de AIM es un flux adhesivo/de retrabajo lavable con agua, diseñado para el retoque o retrabajo general de placas de circuitos impresos, y para la fijación de esferas a paquetes BGA (ball grid array). El flux en pasta WS ofrece una alta actividad y es compatible con todas las aleaciones de estaño-plomo y sin plomo, y puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones. El flux en pasta WS se puede dispensar, transferir por inmersión/pin o imprimir por esténcil. WS está disponible en jeringas de 10 cc y 30 cc.

### APLICACIÓN

Cuando se utiliza en retrabajos, la aplicación debe limitarse únicamente a la zona que se está trabajando. Se recomienda la aplicación mediante aguja dosificadora.

### LIMPIEZA

WS Flux en pasta debe limpiarse con agua normal del grifo. Se recomienda agua desionizada para el último lavado. Una temperatura de 38°C - 60°C (100°F - 150°F) es suficiente para eliminar los residuos. Se recomienda un sistema de limpieza en línea u otro sistema de presurización.

### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Tiempo	Temperatura
Vida útil sellada	6 meses	Temperatura ambiente
Vida útil sellada	1 año	Refrigerada a 4-12°C

WS Flux en Pasta tiene una vida útil sellada de seis (6) meses si se almacena a temperatura ambiente y de un año si se refrigera. No almacene flux en pasta nuevo y usado en el mismo recipiente.

### SEGURIDAD

Utilícese con ventilación adecuada y equipo de protección personal apropiado. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad adjunta para cualquier información específica de emergencia. No deseche ningún material peligroso en recipientes no aprobados.

### RESUMEN DE LOS DATOS DE PRUEBA

Nombre	Método de prueba	Resultados
IPC Flux Clasificación	J-STD-004	ORM1
Nombre	Método de prueba	Resultados
Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	Mediano
Cualitativa Haluros, Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	Haluros presentes
Resistencia de aislamiento superficial	J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3	PASA
Determinación del índice de acidez	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	50.76-56.61 mg KOH por gramo flux Típica
Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	Café oscuro
Viscosidad		Consistencia similar al gel

\*All information for reference only. Not to be used as incoming product specifications or for process design. Consult Certificate of Analysis for product specific information.

**DISCLAIMER** The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. Product information is based upon the assumption of proper handling and operating conditions. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated. Please refer to <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.